

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成19年9月20日(2007.9.20)

【公表番号】特表2006-516361(P2006-516361A)
【公表日】平成18年6月29日(2006.6.29)
【年通号数】公開・登録公報2006-025
【出願番号】特願2006-500897(P2006-500897)
【国際特許分類】

H 0 1 L 23/08 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/08 A

【手続補正書】

【提出日】平成19年8月2日(2007.8.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ヒートシンクフランジと、

前記ヒートシンクフランジに取り付けられている非セラミック系の電氣的絶縁性材料の窓枠と、

前記窓枠に取り付けられているリードと、を有する半導体パッケージであって、

前記窓枠は、ファイバによって満たされ且つ金属被覆されたポリテトラフルオロエチレンのマトリクスによって形成されており、前記金属被覆はニッケル及び／又は金によってメッキされており、前記窓枠は前記フランジ及び前記リードにろう付け／はんだ付け／接着剤によってろう付けされていることを特徴とする半導体パッケージ。

【請求項2】

前記窓枠は銅によって被覆されており、前記フランジ及び前記リードの少なくとも一方が前記窓枠の前記銅被覆の一部を含むことを特徴とする請求項1記載の半導体パッケージ。

【請求項3】

前記窓枠は前記フランジに所定の融解温度を有する金／ゲルマニウムはんだによって結合され、前記半導体パッケージは前記金／ゲルマニウムはんだの前記所定の融解温度より低い融解温度を有する金／スズ混合物によって前記フランジに結合しているダイを更に有していることを特徴とする請求項1記載の半導体パッケージ。